

Title (en)
Connector for a printed circuit board

Title (de)
Steckverbinder für Leiterplatte

Title (fr)
Connecteur pour carte de circuit imprimé

Publication
EP 2466692 A1 20120620 (FR)

Application
EP 11193625 A 20111214

Priority
FR 1060607 A 20101216

Abstract (en)
The connector has a contact piece (8) received in a body (2) with interposition of an insulator (7). A case (3) defines a housing (6) to receive entire or part of the body. A frame (14) is arranged around a case portion (13). A body portion (5) is received in the case portion. The frame comprises tabs (18) that permit fixation of the connector with a printed circuit board. The tabs are projected above the case portion around which the frame is arranged. The frame is made of metal and arranged relative to the case in a fitted manner. Independent claims are also included for the following: (1) a connection assembly comprising two connectors (2) a system comprising a connector.

Abstract (fr)
La présente invention concerne un connecteur (10), comportant : - un corps, - au moins un contact (8) reçu dans le corps avec interposition d'un isolant, - un boîtier (3) définissant un logement configuré pour recevoir tout ou partie du corps, - une armature disposée autour d'au moins une portion du boîtier (3), au moins une portion du corps étant reçue dans ladite portion du boîtier (3), l'armature comportant des pattes (18) permettant la fixation du connecteur à une carte de circuit imprimé, caractérisé par le fait que lesdites pattes (18) font saillie au-delà de la portion du boîtier (3) autour de laquelle l'armature est disposée et par le fait que l'armature (14) est disposée relativement au boîtier de façon encastrée.

IPC 8 full level
H01R 13/502 (2006.01); **H01R 12/57** (2011.01); **H01R 12/72** (2011.01); **H01R 13/6594** (2011.01); **H01R 13/6582** (2011.01)

CPC (source: EP US)
H01R 12/724 (2013.01 - EP US); **H01R 13/6594** (2013.01 - EP US); **H01R 2201/26** (2013.01 - EP US)

Citation (applicant)
US D456355 S 20020430 - TOGASHI KOJI [JP]

Citation (search report)
• [XY] US 2010055979 A1 20100304 - WANG HONG-WU [CN], et al
• [X] US 2010105226 A1 20100429 - GONG HONG-BIN [CN], et al
• [X] US 2008124956 A1 20080529 - WU JIAN-FENG [CN]
• [X] US 4913664 A 19900403 - DIXON DANIEL A [US], et al
• [X] US 2009247013 A1 20091001 - TSUZAKI NOZOMI [JP], et al
• [Y] US 2005221673 A1 20051006 - MYER JOHN M [US], et al
• [Y] US 2010075542 A1 20100325 - HO HSIN-TSUNG [TW]
• [Y] US 2007049124 A1 20070301 - CHIEN MIN-LING [TW], et al

Cited by
EP2827459A1; CN104300268A; US9385480B2

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 2466692 A1 20120620; **EP 2466692 B1 20160706**; CN 102544870 A 20120704; CN 102544870 B 20170301; FR 2969400 A1 20120622; FR 2969400 B1 20130830; US 2012156921 A1 20120621; US 9004944 B2 20150414

DOCDB simple family (application)
EP 11193625 A 20111214; CN 201110416837 A 20111214; FR 1060607 A 20101216; US 201113324333 A 20111213